

タツモ株式会社 決算説明資料

2023年12月期第3四半期

2023年11月13日発表

タツモ株式会社



会社案内ダウンロード



単位：百万円

	'22年 3Q	'23年 3Q	売上比 (%)	今期計画 (通期)	達成率 (%)
売上高	16,958	19,034	—	31,423	60.6
売上総利益	4,589	5,944	31.2	—	—
販管費	3,208	3,539	18.6	—	—
営業利益	1,381	2,405	12.6	3,118	77.1
経常利益	2,001	2,690	14.1	3,087	87.1
親会社株主に帰属する 四半期純利益	1,426	1,539	8.1	2,109	73.0

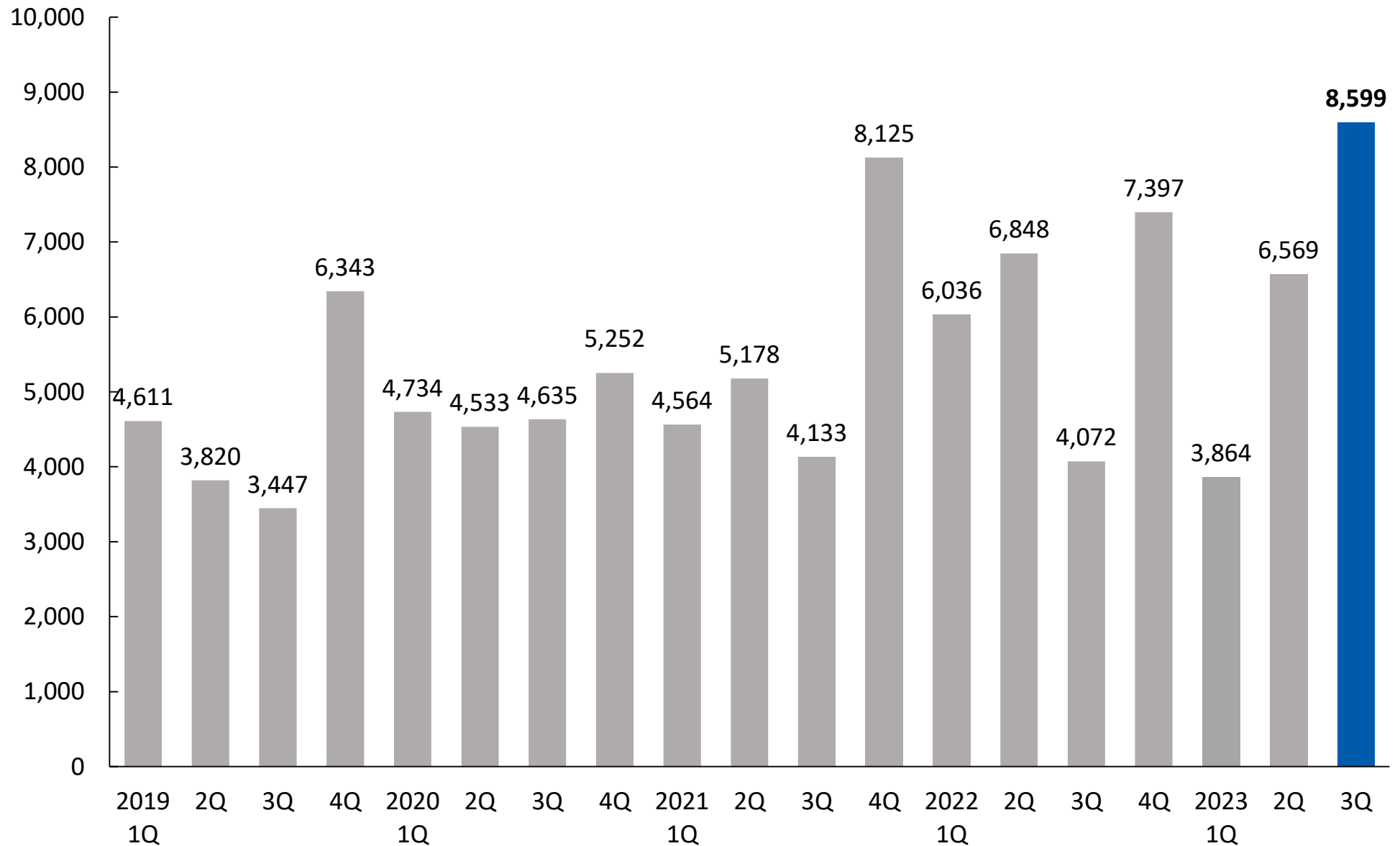
売上高は前年同期比で12.2%増。営業利益も前年同期比74.1%増

計画達成率売上高60.6%、営業利益77.1%、経常利益87.1%、四半期純利益73.0%

引続き検収遅延により売上高は計画に対し遅れ気味に推移

利益面では量産効果や原価低減などにより上振れて推移

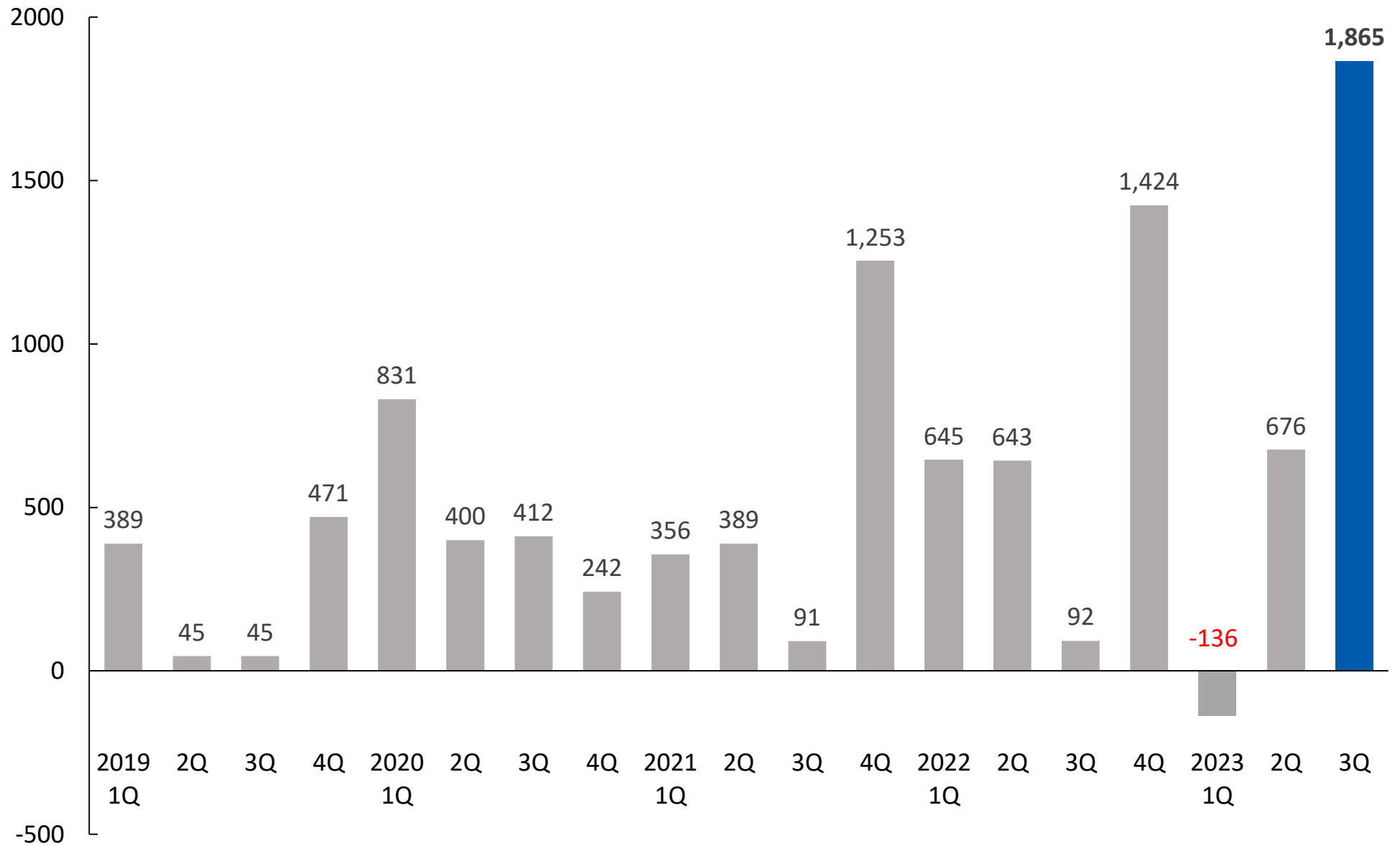
単位：百万円



連結営業利益推移

TAZMO

単位：百万円



連結貸借対照表

TAZMO

単位：百万円

	'22年12月期	'23年3Q	増減
流動資産	31,905	39,853	7,948
有形固定資産	6,267	6,789	522
無形固定資産	198	222	24
投資その他資産	1,025	785	△240
総資産	39,397	47,650	8,253
流動負債	18,463	21,762	3,299
固定負債	3,384	6,278	2,894
純資産	17,549	19,609	2,060
自己資本比率	43.9%	40.4%	△3.5

連結貸借対照表 主な増減

TAZMO

単位：百万円

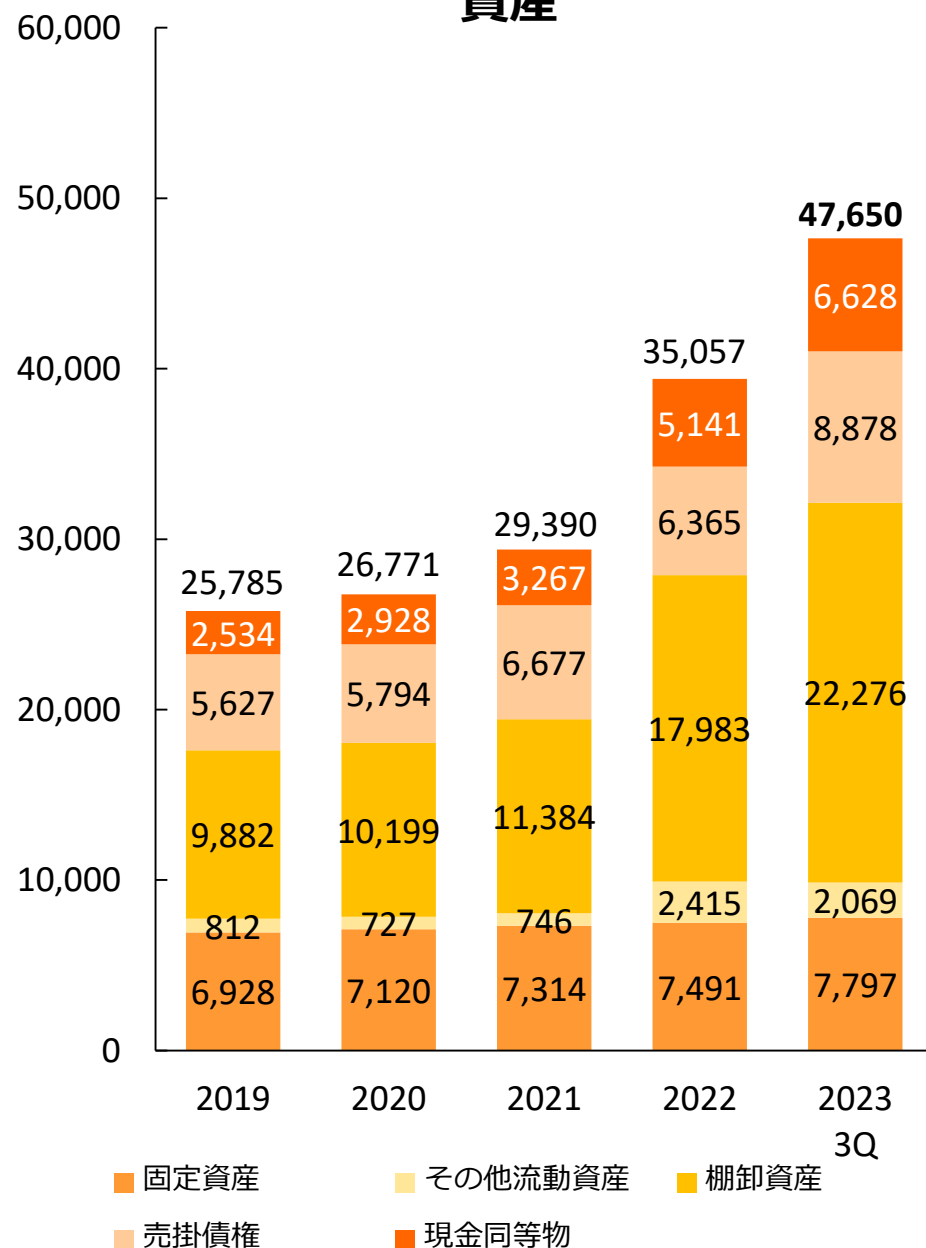
主な増減		
資産		
	'23年3Q	前期末比
現金及び預金	6,628	1,487
受取手形及び売掛金	5,954	1,458
電子記録債権	2,924	1,054
棚卸資産	22,276	4,292
負債		
	'23年3Q	前期末比
電子記録債務	3,390	△960
短期借入金	7,361	2,082
契約負債	6,189	2,497
有償支給取引に係る負債	—	△577
長期借入金	5,503	2,860

資産・負債／純資産推移

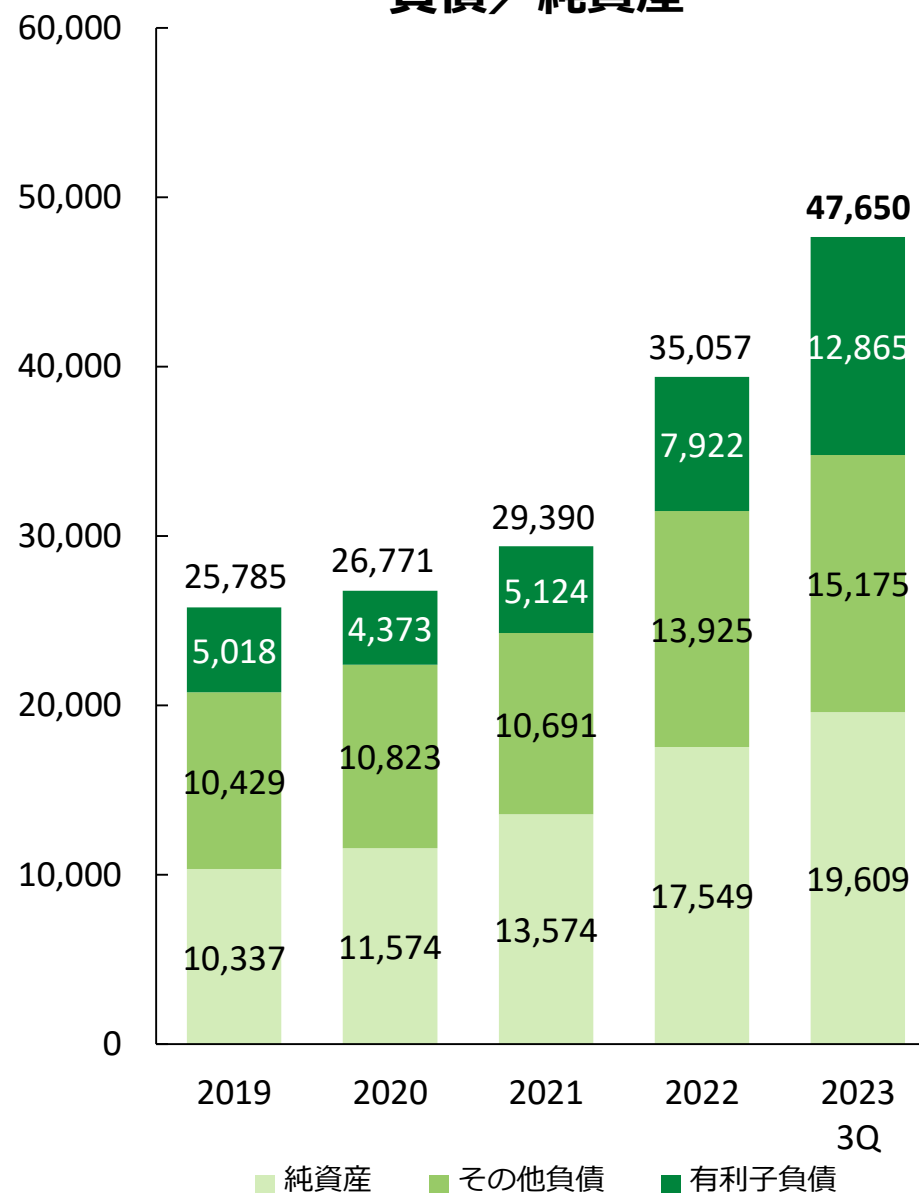
TAZMO

単位：百万円

資産



負債／純資産



セグメント別業績

TAZMO

単位：百万円

	'22年 3Q	'23年 3Q	売上比 (%)	今期計画 (通期)	達成率 (%)
売上高	16,958	19,034	—	31,423	60.6
プロセス機器事業	13,222	14,497	76.2	22,974	63.1
半導体装置	3,853	4,343	22.8	8,222	52.8
搬送機器	5,108	6,140	32.3	7,453	82.4
洗浄機	1,621	2,604	13.7	4,412	59.0
コーター	2,638	1,408	7.4	2,885	48.8
金型・樹脂成形事業	1,077	1,137	6.0	2,156	52.7
表面処理用機器事業	2,658	3,399	17.9	6,292	54.0

搬送機器以外は依然として複数の検収遅れが発生 年内検収が難しい案件も出てきている

半導体装置	：前年同期比12.7%増	通期計画達成率52.8%	依然として検収遅れあり
搬送機器	：前年同期比20.2%増	通期計画達成率82.4%	順調に推移
洗浄機	：前年同期比60.6%増	通期計画達成率59.0%	依然として検収遅れあり
コーター	：前年同期比46.6%減	通期計画達成率48.8%	依然として検収遅れあり
表面処理	：前年同期比27.9%増	通期計画達成率54.0%	依然として検収遅れあり

セグメント別業績

TAZMO

単位：百万円

単位：百万円	'22年 3Q	'23年 3Q	売上比 (%)	今期計画 (通期)	達成率 (%)
営業利益	1,381	2,405	—	3,118	77.1
プロセス機器事業	1,325	2,333	12.3	2,731	85.4
金型・樹脂成形事業	21	19	0.1	56	33.9
表面処理用機器事業	60	69	0.4	330	20.9
セグメント間連結消去	△26	△17	—	—	—

プロセス機器事業：半導体装置の利益率向上 通期計画達成率85.4%

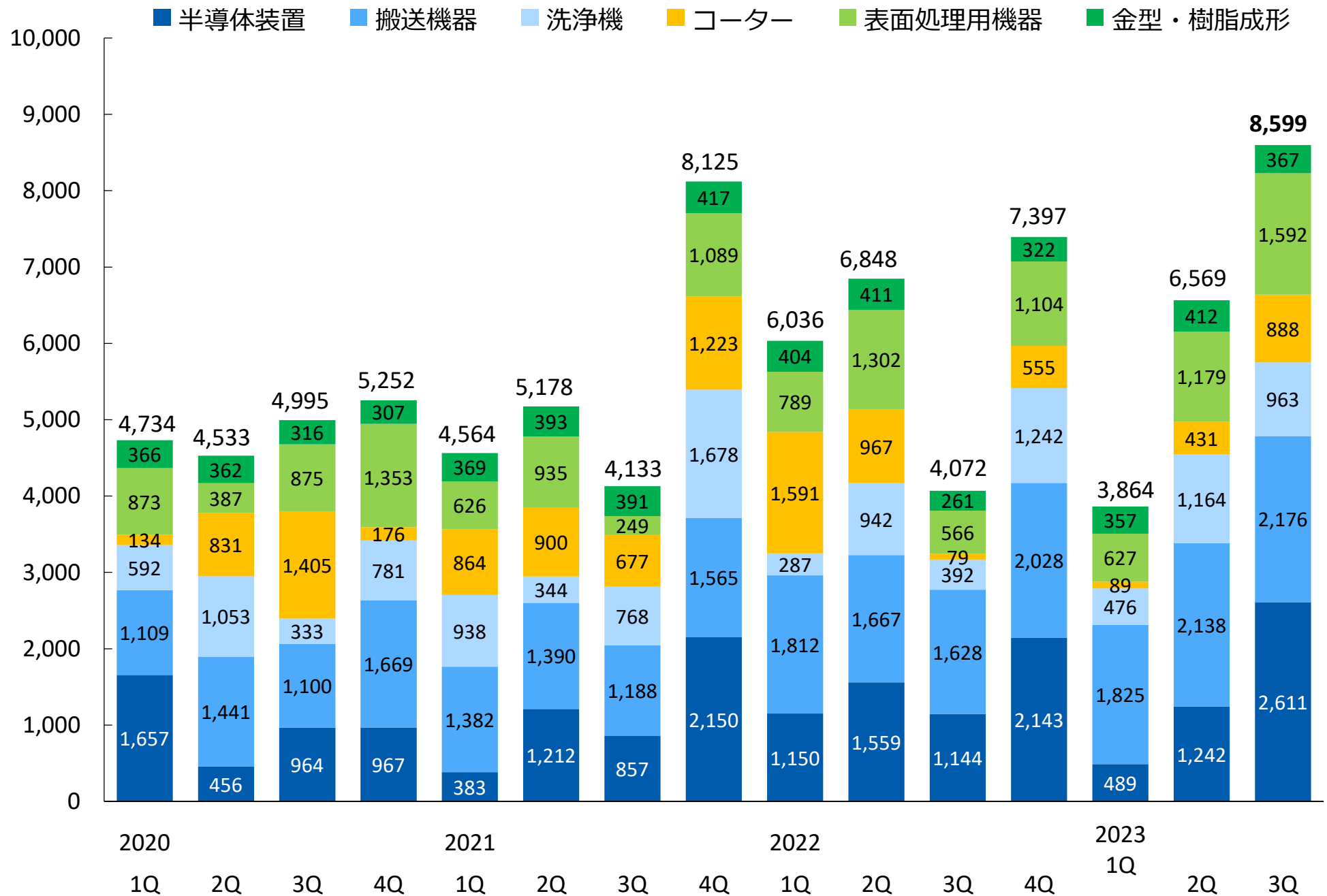
金型・樹脂成形事業：前年同期比9.5%減 通期計画達成率33.9% 売上案件少ない

表面処理用機器事業：3Qで黒字化 前年同期比15%増も通期計画達成率20.9%

セグメント別 売上高推移

TAZMO

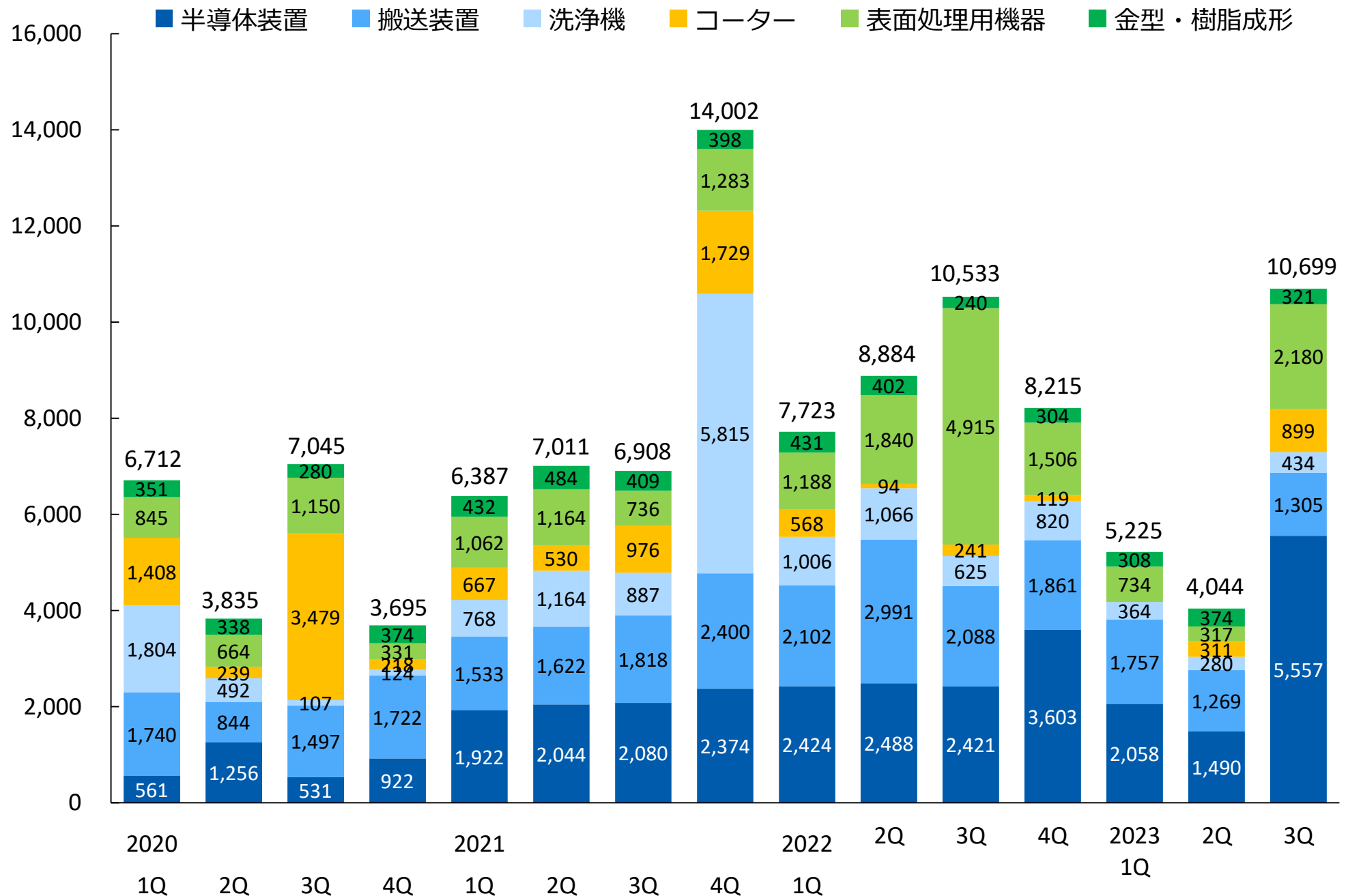
単位：百万円



セグメント別 受注高推移

TAZMO

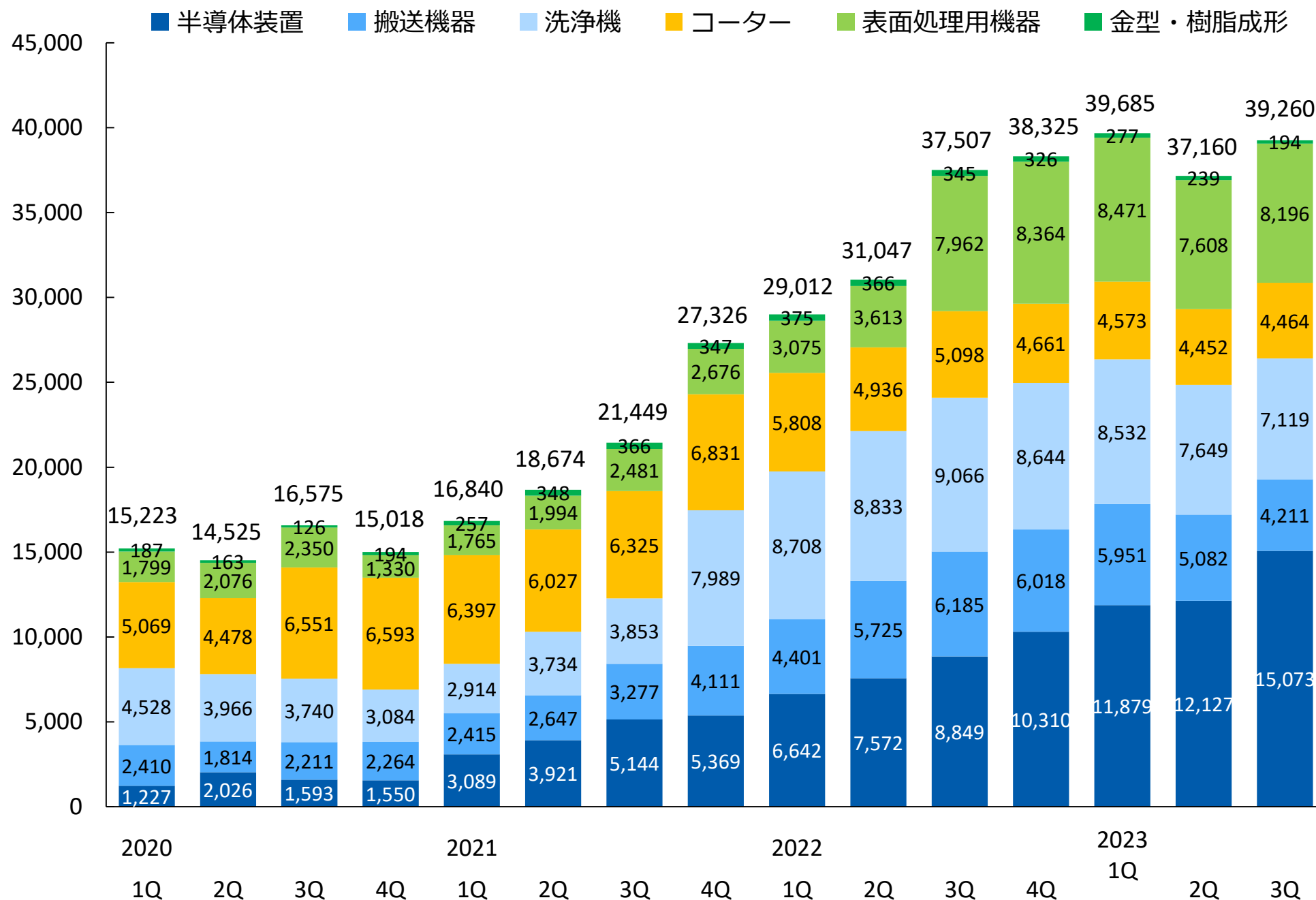
単位：百万円



セグメント別 受注残高推移

TAZMO

単位：百万円



依然として検収タイミングの遅延が発生している。半導体業界の減速の長期化による投資抑制が続いており、回復にはもう少し時間がかかると予測。

半導体装置

パワー半導体向けで装置立ち上げの調整により、検収遅れの案件が多くなっている。また、次の投資案件も延期の話が出てきており、パワー半導体関係の設備投資の状況も弱まってきている。一方、アドバンスドパッケージ向け装置で大口受注。納期が厳しいが外製比率を上げ生産計画を調整中。

搬送機器

増強した生産キャパにより売上は計画以上で推移している。半導体業界の市場状況の影響を受け、受注件数は低下。回復時期が見えない。

洗浄機

お客様都合での検収遅れが続いている。徐々に検収となってきているが、今期検収が難しい案件も出てきている。

表面処理

引き続き生産能力一杯。売上計画よりも遅延気味に推移している。
国内外共に引合いは多く、大口案件受注。製造キャパ拡大を検討中。

部品調達

全体的に部品の入手は改善傾向にあるが、部品によっては未だ入手困難な状況にあり、短納期案件向けの部品調達で苦戦している。

人としての優しさと卓越した創造力を基本に、
あくなき「**挑戦**」によって、豊かな未来社会の創造に貢献する

商号	タツモ株式会社
設立	1972年（昭和47年）2月26日
本社所在地	岡山県岡山市北区芳賀5311
資本金	35億5,689万6,587円
発行済株式数	14,836,691株
株主数	3,869名（2023年6月30日現在）
従業員数	単体 374名/連結 1,137名（2023年6月30日現在）
事業内容	半導体製造装置、半導体製造用搬送装置、 液晶製造装置、紫外線照射装置、 めっき処理装置、精密金型・樹脂成型品 などの開発・製造・販売



- 1972 電子機器部品の製造及び設備の修繕を目的として設立
- 1980 インジェクション金型他、金型の製造・販売を開始
半導体製造用全自動レジスト塗布装置を開発、製造・販売を開始
- 1989 液晶用カラーフィルター製造装置を開発、製造・販売を開始
- 1990 本社・本社工場を新築、岡山県井原市木之子町6186番地に移転
スパークリーンルーム用超小型搬送システムを開発、製造・販売を開始
- 1994 エンボスキャリアテープの製造・販売を開始
- 1995 インジェクション成形品の製造・販売を開始
- 2001 半導体製造用厚膜コーター「CS13」シリーズを開発、製造・販売を開始
- 2004 JASDAQ市場に株式を上場
- 2008 TAZMO VIETNAM CO.,LTD.（ベトナム：ホーチミン市）を設立

2009 第10世代対応カラーフィルター製造装置を開発、製造・販売を開始

3M社（米国）と半導体製造装置のライセンス契約を締結

2013 アプリシアテクノロジー株式会社を子会社化

ハノイ省ハノイ工業団地内にTAZMO VIETNAM CO.,LTD.を移転・新築

2017 株式会社ファシリティ、株式会社クォークテクノロジーを子会社化

2018 東京証券取引所市場第一部へ市場変更

2019 本社を岡山県岡山市北区芳賀5311番地に移転

2020 アプリシアテクノロジー株式会社を吸収合併

2022 東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所市場第一部からプライム市場に移行

公募増資により、資本金34億9,540万円へ増資

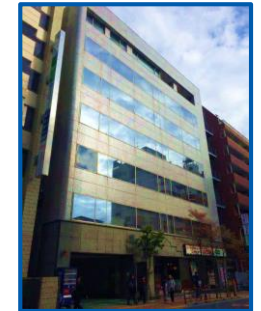
中国における半導体関連機器の製造・販売拠点として龍雲（紹興）半導体設備科技有限公司を浙江省紹興市に設立



タツモ第1工場



ファシリティ
出雲研究所



タツモ東京営業所



タツモ第3工場



タツモ第5工場

島根県出雲市

東京都新宿区



ファシリティ本社

岡山県井原市

神奈川県相模原市

岡山県岡山市



クオークテクノロジー



プレテック



タツモ本社



富萊得科技(東莞)有限公司



富萊得(香港)有限公司



龍雲阿普理夏电子科技有限公司



上海龍雲精密機械有限公司

東莞

香港

上海

サンフランシスコ

紹興

ベトナム

台湾



龍雲(紹興)半導体設備
科技有限公司



TAZMO INC



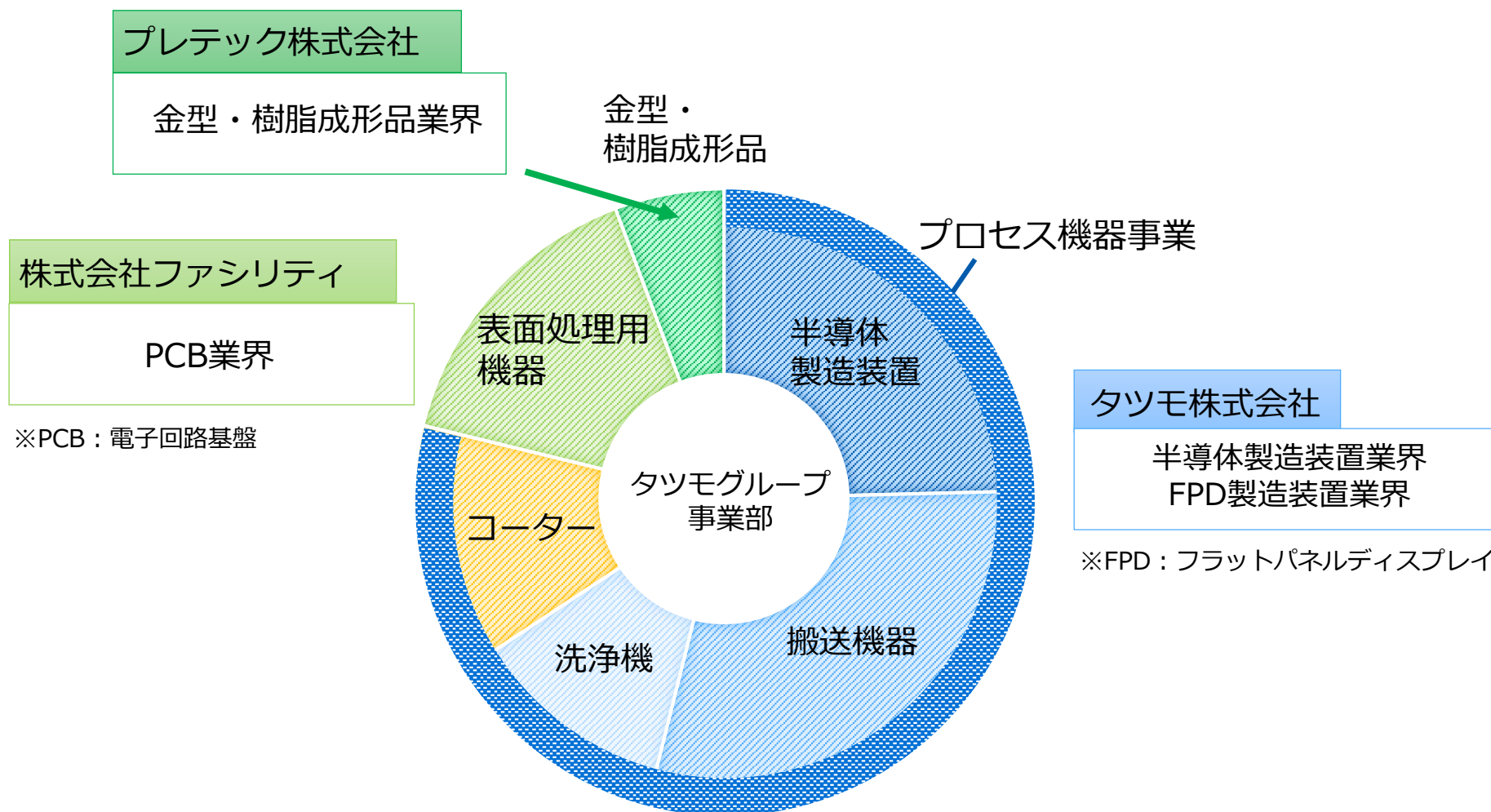
TAZMO VIETNAM CO.,LTD.



FACILITY HANOI CO.,LTD.



龍雲亞普恩科技股份有限公司



半導体製造装置、搬送ロボット、液晶製造装置、精密金型、樹脂成形品、めっき処理装置等の開発・製造・販売

半導体製造装置事業

半導体製造に用いられる薬液の塗布・現像装置や、シリコンウェーハ薄化のために支持体とウェーハを仮接合・剥離する装置等の開発・製造・販売



搬送機器事業

半導体製造装置に用いられるシリコンウェーハ等搬送ロボットやアライメント機器、またそれらをユーザー別の仕様にユニット化した製品等の開発・製造・販売



洗浄装置事業

半導体製造に用いられるシリコンウェーハ洗浄装置や、スラリーの供給装置、リン酸再生装置などの開発・製造・販売



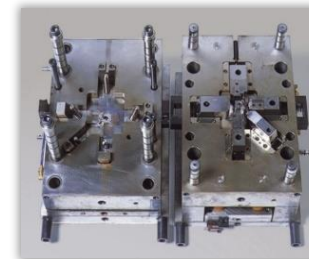
コーター事業

液晶カラーフィルター製造装置向けを中心としたガラス基板への薬液塗布装置の開発・製造・販売



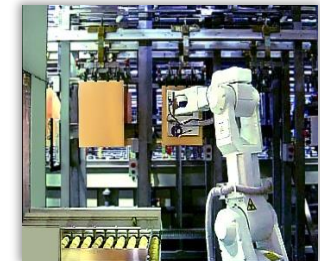
金型・樹脂成形品事業

電子機器部品用の金型の製作及び、その金型を使ったコネクタ等の樹脂成形品、エンボスキャリアテープの製造・販売



表面処理用機器事業

めっき処理装置や回路形成装置等のプリント基板製造装置等の開発・製造・販売



本資料の取扱い上の注意

本資料は、2023年11月13日発表の決算短信に基づいて作成されております。

また、本資料に記載されている業績予測等は、現在入手可能な情報に基づいて作成されたものであり、実際の業績は様々な要因により予想数値と異なる場合があります。

掲載内容には最新の注意を払っておりますが、掲載されて無いように基づいて被った損害については、弊社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

本資料に関するお問い合わせ先

タツモ株式会社 経営企画室

TEL 086-239-5000

FAX 086-239-5100

Email keiki@tazmo.co.jp



TAZMO